

【原因、判断要点、发生工序】由于抗蚀膜破裂等，导通孔内壁被 E T 液腐蚀而造成的（曝光工序、E T 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Etchant for forming conductor pattern etches via hole wall due to the break of etching resist. (Exposure, etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-1-4-13 ブラビアめっき不析出断線／盲孔无镀层的开路 / Open by non-plated blind via

【特徴】レーザ加工ブラインドビアホール底コーナー部にめっき銅がリング状に欠落し、下ランド上のめっき銅とは接続していない状態のスルーホール断線

【特征】在盲孔底部的拐角欠缺环状的镀铜层，镀铜层不能上下连接的开路。

【Characteristics】The bottom corner of a laser drilled blind via hole is not plated circumferentially and the plated copper is not connected to the via bottom land.

【原因・判断ポイント・発生工程】スルーホールめっき前処理における、コンディショニングやキャタライジング、アクセラレーティングなどが不完全なために、スルーホールめっきが析出しなかったために出来たもの

【原因、判断要点、发生工序】在 PTH 前处理时，由于预处理、催化处理、或者沉积速率处理不完善，导致通孔不沉积铜而引起的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Copper is not deposited entirely over the hole surface because of imperfect pre-treatment for electroless plating such as plating condition, catalyzer or acceleration and the open is formed.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×